

【原因、判断要点、发生工序】元件封装的焊料在冷却时，热应力不平衡而引起的（元件封装工序）

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder for component mounting (Component mounting process)

【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×

10-1-6 スルーホールめっき剥離／通孔镀层剥离 / Separation of through-hole plating

【特徴】スルーホール外壁と基板樹脂部の界面で剥離している状態の欠陥

【特征】通孔外壁从板树脂的界面剥离的缺陷。

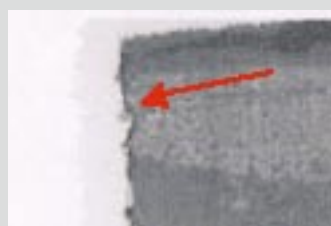
【Characteristics】The plating of a PTH is separated from the base material at the hole wall.

【起因・判断ポイント・発生工程】電子部品実装はんだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスにより出来たもの（電子部品実装工程）

【原因、判断要点、发生工序】元件封装的焊料在冷却时，热应力不平衡而引起的（元件封装工序）

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting process)



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 200

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 × 200

【Comments】
Microsection
Magnification: ×200

【コメント】
断面
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 ×

【Comments】
Microsection
Magnification: ×

10-1-7 はんだスルーホール内壁剥離／通孔内壁的焊料剥离 / Separation of solder from PTH wall

【特徴】スルーホール内壁とはんだの界面で剥離している状態の欠陥

【特征】通孔内壁从焊接界面剥离的缺陷。

【Characteristics】The solder is separated from the PTH at the interface.

【起因・判断ポイント・発生工程】電子部品実装はんだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスにより出来たもの（電子部品実装工程）



【コメント】
断面
顕微鏡倍率 × 40

【注釋】
截面
顕微鏡倍率 × 40

【Comments】
Microsection
Magnification: ×40